

无铅焊接 微焊接技术分析与工艺设计



[无铅焊接 微焊接技术分析与工艺设计_下载链接1](#)

著者:宣大荣

出版者:

出版时间:2008-5

装帧:

isbn:9787121061325

《无铅焊接·微焊接技术分析与工艺设计》对焊料无铅化的背景、无铅焊料基本物理特

性要求、无铅焊接界面评价方法、电子元器件无铅化技术要求、无铅回流焊、波峰焊工艺设计思路及应用实例效果、无铅手工焊接工艺、无铅焊接的可靠性结构要素等给予了详细的分析、解说。同时，对于SMT组装的微焊接工艺设计顺序方法和不同贴装元器件的具体设计应用案例也做了系统阐述。

《无铅焊接·微焊接技术分析与工艺设计》是电子制造企业工程技术人员从事无铅化组装的必备参考资料，也可作为相关专业大中专院校师生的参考指导用书。

作者介绍:

目录:

[无铅焊接 微焊接技术分析与工艺设计_下载链接1](#)

标签

评论

[无铅焊接 微焊接技术分析与工艺设计_下载链接1](#)

书评

[无铅焊接 微焊接技术分析与工艺设计_下载链接1](#)